

2021年2月1日

各 位

会 社 名 京セラ株式会社
代表者名 取締役社長 谷本 秀夫
(コード番号 6971 東証第1部)
問合せ先 取締役 執行役員常務 青木 昭一
(TEL (075)604-3500)

京セラグループにおける吸収合併に関するお知らせ

京セラ株式会社（以下、「当社」）は、2021年2月1日開催の取締役会において、2021年4月1日を効力発生日として、当社100%子会社である京セラ宇部RFテック株式会社（以下、「京セラ宇部RFテック」）の吸収合併を行うことを決議しましたのでお知らせします。

なお、本吸収合併は簡易合併に該当するため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 吸収合併の目的

現在、京セラグループは、5Gならびにポスト5G通信システム市場向けに様々な部品やモジュール等の開発、製造、販売に注力しています。その一環として当社は、通信基地局向けセラミックフィルタの開発技術の取得を目的に、2019年12月1日に宇部興産株式会社との合併会社として京セラ宇部RFテックを設立しました。当社は、2021年1月28日に宇部興産株式会社の保有する京セラ宇部RFテック株式をすべて取得し、同社を100%子会社としたうえで、2021年4月1日に吸収合併します。

本吸収合併は、セラミックフィルタ事業の採算改善を目的とするものです。

2. 吸収合併の要旨

(1) 合併の日程

京セラ宇部RFテック合併契約書承認取締役会	2021年2月1日
当社合併契約書承認取締役会	
合併契約書調印 (注) 当社は会社法第796条第2項（簡易合併手続）の規定により、京セラ宇部RFテックは同法第784条第1項（略式合併手続）の規定により、株主総会の承認を受けずに合併します。	
合併期日	2021年4月1日(予定)
合併登記	2021年4月1日(予定)

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、京セラ宇部RFテックは解散します。

(3) 合併に係る割当の内容

100%子会社との合併であり、金銭等の交付は行いません。

(4) 合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(5) 合併当事会社の概況 (2020年9月30日現在)

	存続会社	消滅会社
1) 名称	京セラ(株)	京セラ宇部 RF テック(株)
2) 所在地	京都府京都市伏見区 竹田鳥羽殿町 6 番地	滋賀県野洲市市三宅 800 番地 (京セラ(株)滋賀野洲工場内)
3) 代表者の 役職・氏名	取締役社長 谷本 秀夫	取締役社長 小西 公紀
4) 事業内容	産業・自動車用部品 半導体関連部品 電子デバイス コミュニケーション 生活・環境関連事業等	通信基地局向けセラミック フィルタの開発・製造・販売
5) 資本金	115,703 百万円	450 百万円
6) 設立年月日	1959 年 4 月 1 日	2004 年 1 月 5 日 (宇部興産(株)の子会社ユー・イー・ エル(株)として)
7) 発行済 株式総数	377,618,580 株 (内、自己株式 15,176,543 株)	9,000 株 (内、自己株式 0 株)
8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
9) 大株主及び 持株比率	日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 16.17% (株)日本カストディ銀行(信託口) 6.96% (株)京都銀行 3.98% SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 3.79% 稲盛 和夫 2.82% (自己株式を除いた比率)	京セラ(株) 51.00% 宇部興産(株) 49.00% (2021年1月28日付で、当社が 宇部興産(株)持分を取得)

(6) 合併当事会社の経営成績及び財政状態 (2020年3月期)

(単位:百万円)

	京セラ(株)	京セラ宇部RFテック(株)
純資産	2,015,786	175
総資産	2,520,096	824
1株当たり純資産(円)	5,561.83	19,450.51
売上高	730,388	662
営業利益	△698	△380
経常利益	98,356	△412
当期純利益	88,466	△414
1株当たり当期純利益(円)	244.20	△45,960.95

(7) 合併後の当社の状況

本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期の変更はありません。

(8) 今後の見通し

本合併は、当社及び当社100%子会社を当事者とする吸収合併であり、また、合併期日は2021年4月1日を予定しているため、本合併が当社の2021年3月期連結業績予想に及ぼす影響はありません。

以上